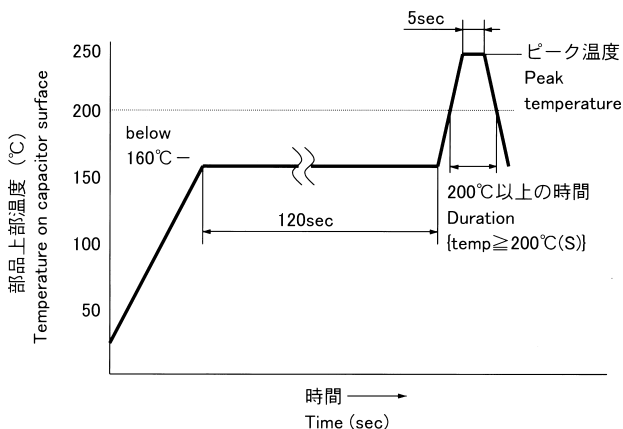


リフロー許容条件 REFLOW SOLDERING CONDITION

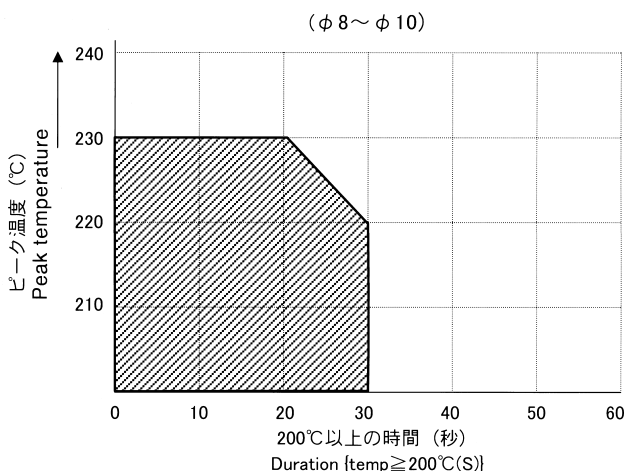
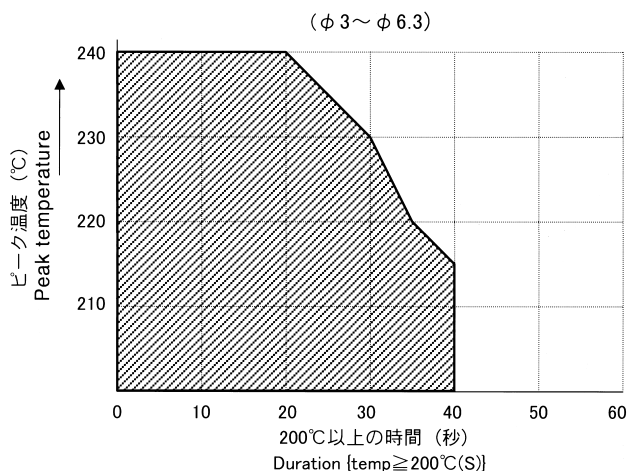
リフローは赤外熱風併用等の雰囲気熱伝導方式を使用し、VPS（蒸気熱伝導方式）は使用しないで下さい。  
 For reflow, use a thermal conduction system such as infrared radiation (IR) or hot blast.  
 Vapor heat transfer systems (VPS) are not recommended.

プロファイル Profile

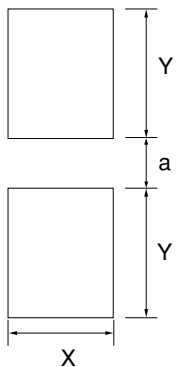


- プリヒートは 160°C 以下で 120 秒以内として下さい。  
Preheat shall be made at maximum 160°C and for maximum 120 seconds.
- コンデンサ頭部の温度が 200°C をこえる時間及びピーク温度は、ピーク温度マトリックス以内として下さい。  
The duration for over +200°C temperature at capacitor top shall be within peak temperature matrix.
- 許容範囲をこえる場合は、弊社にご相談下さい。  
If capacitors are subject to the conditions other than the allowable range of reflow, please contact to us.

ピーク温度マトリックス Peak temperature matrix



推奨ランド寸法 RECOMMENDED LAND SIZE



ケースサイズ Case Size	X (mm)	Y (mm)	a (mm)
φ 3	1.6	2.2	0.8
φ 4	1.6	2.6	1.0
φ 5	1.6	3.0	1.4
φ 6.3	1.6	3.5	2.1
φ 8 × 6.2L	2.5	4.0	2.1
φ 8 × 10.2L	2.5	3.5	3.0
φ 10 × 10.2L	2.5	4.0	4.0